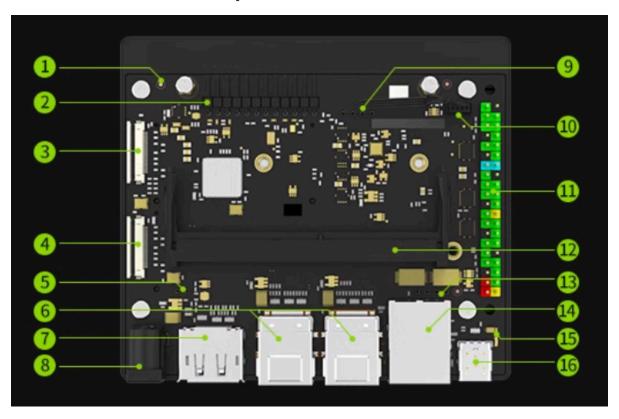
Motherboard Introduction

1. Jetson Orin Development Kit

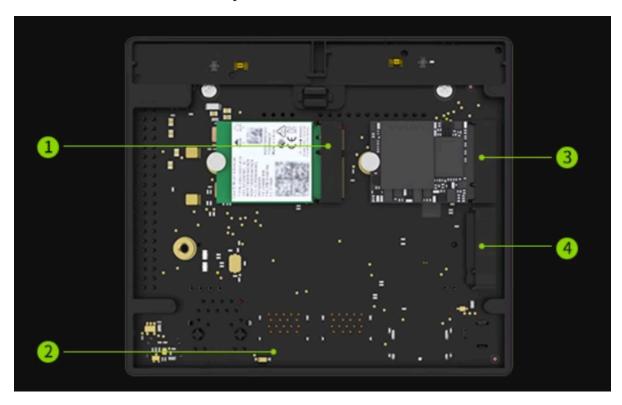
The main difference between the Jetson Orin official development kit and the SUB version development kit: the official kit does not have ① switch button

1.1. Front of the development board



Serial number	Description	Serial number	Description
1	Power switch button (SUB)	9	CAN bus
2	12Pin button row	10	Fan interface
3	Camera interface 1 (22pin)	11	40-Pin GPIO expansion interface
4	Camera interface 2 (22pin)	12	Core module card holder
5	PoE reverse power supply interface (1x2pin)	13	PoE interface
6	USB 3.0*4	14	Ethernet interface
7	DisplayPort interface	15	Power indicator
8	Power interface	16	USB Type C

1.2. Back of the development board



Serial number	Description	Serial number	Description
1	M.2 Key E connector slot (75-pin)	3	M.2KeyM slot (75- pin)
2	RTC battery holder (optional)	4	M.2KeyM slot (75- pin)

2. Jetson Orin module parameters							

	Jetson AGX Orin 系列			Jetson Orin NX 系列		Jetson Orin Nano 系列				
	Jetson AGX Orin 开发者套 件	Jetson AGX Orin 64GB	Jetson AGX Orin 工业版	Jetson AGX Orin 32GB	Jetson Orin NX 16GB	Jetson Orin NX 8GB	Jetson Orin Nano Super 开 发者套件	Jetson Orin Nano 8GB	Jetson Orin Nano 4GB	
AI 性能	275 T	OPS	248 TOPS	200 TOPS	157 TOPS	117 TOPS	67 TOPS	67 TOPS	34 TOPS	
GPU	搭载 64 个 Tensor Core 的 2048 核 N' 构 GPU		VIDIA Ampere 架	搭载 56 个 Tensor Core 的 1792 核 NVIDIA Ampere c GPU			搭載 32 个 Tensor Core 的 1024 核 513		搭載 16 个 Tensor Core 的 512 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU	
GPU 最大频率	1.3 G	iHz	1.2 GHz	930 MHz	1173MHz	1173MHz	1020MHz	1020MHz	1020MHz	
СРИ	12 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.3 3MB L2 + 6MB L3		º 64 位 CPU			Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 +	6 核 Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3			
CPU 最大频率	2.2 0	SHz	2.0 GHz	2.2 GHz	2 GHz		1.7 GHz	1.7 GHz	1.7 GHz	
DL 加速器			2x NVDLA v2			1x NVDLA v2		-		
DLA 最大频率	1.6 G	iHz	1.4	1.4 GHz		1.23 GHz		-		
视觉加速器			lx P	VA v2				-		
安全集群引擎			-			-		-		
显存		64GB 256 位 LPDDR5 204.8GB/s		32GB 256 位 LPDDR5 204.8GB/s	16GB 128 位 LPDDR5 102.4GB/s	8GB 128 位 LPDDR5 102.4GB/s	8GB 128 位 LPDDR5 102 GB/s	8GB 128 位 LPDDR5 102 GB/s	4GB 64 位 LPDDR5 51 GB/s	
存储		64GB eMMC 5.1 (支			(支持外部	- 鄧 NVMe)	(配备 SD 卡插 槽,且支持通 过 M.2 Key M 连接外部 NVMe)			
视频编码	2x 4K60 4x 4K30 8x 1080p6 16x 1080p3	H.265) (H.265) 3x 4K30 (H.265) 1 (H.265) 7x 1080p60 6x 1080p60 (H.265)					1080p30,由 1-2 个 CPU 核心提供支持			
视频解码	1x 8K30 3x 4K60 7x 4K30 11x 1080p6 22x 1080p3	0 (H.265) (H.265) 7x 4K30 (H.265) (H.265) (H.265) (H.265) (H.265)			1x 8K30 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265		1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265)			
CSI 摄像头	16 通道 MIPI CSI-2 连接器		多达 6 个摄像头(通过虚拟通道支持 16 个) 16 通道 MIPI CSI-2 D-PHY 2.1(高达 40 Gbps)【C-PHY 2.0(高达 164 Gbps)			多达 4 个摄像头(通过虚拟通道支持 8 个**) 8 通道 MIPI CSI-2 D-PHY 2.1(高达 20 Gbps)		多达 4 个摄像头(通过虚拟通道支持 8 个***) 8 通道 MIPI CSI-2 D-PHY 2.1(高达 20 Gbps)		
PCle*	x16 PCle 插 槽,支持 x8 PCle 4.0 M.2 Key M 插 槽,支持 x4 PCle 4.0 M.2 Key E 插 槽,支持 x1 PCle 4.0	高达 2 x8 + 1 x4 + 2 x1 (PCle 4.0、根端口和端点)			1 x4 + 3 x1 (PCIe 4.0、根端口和端点)		M.2 Key M 插槽, 支持 x4 PCle 3.0 M.2 Key M 插槽, 支持 x2 PCle 3.0 M.2 Key E 插槽	1 x 4 + 3 x l (PCle 3.0、根端口和端点)		
USB*	USB Type-C连 接器: 2x USB 3.2 2.0 USB Type-A连 接器: 2x USB 3.2 2.0、2x USB 3.2 1.0 USB Micro-B 连接器: USB 2.0	3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) 4x USB 2.0			3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) 3x USB 2.0		USB Type-A 连 接器: 4k USB 3.2 2.0 适用于 UFP 的 USB Type-C 连 接器	3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) 3x USB 2.0		
网络*	RJ45 连接器, 至高可支持 10 GbE	1x GbE 1x 10GbE			1x GbE		1xGbE 连接器	1x GbE		
显示器	1x DisplayPort 1.4a (+MST) 连 接器	1x 8K60 多模 DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1			1x 8K30 多模 DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1		1x DisplayPort 1.2 (+MST) 连 接器			
其他 I/O	40 针接头 (UART、 SPI、I2S、I2C、CAN、 PWMM、 DMIC、 GPIO) 12 针自动化接 针自动化接 手 等头 10 针 JTAG 接 4 针风压电池 & Wite 选择	4x UART、3x SPI、4x I2S、8x I2C、2x CAN、PWM、 DMIC和 DSPK、GPIO			12C、1x CAN、[SPI、2x I2S、4x DMIC 和 DSPK、 、GPIO	40 针扩展接头 (UART, SPI, I2S, I2C, GPIO) I2 针按钮接头 MicroSD 插槽 直流电源插座	I2C、1x CAN、[SPI、2x I2S、4x MIC 和 DSPK、 GPIO	

	microSD 插槽 直流电源插座 电源、强制恢 复和复位按钮								
功耗	15 瓦 - 6	60 瓦	15 瓦 - 75 瓦	15 瓦 - 40 瓦	10 瓦 - 25 瓦	10 瓦 - 20 瓦	7瓦-	15 瓦	7瓦-10瓦
规格尺寸	110 毫米×110 毫米×71.65 毫 米 (高度包括支 架、载板、模 组和散热解决 方案)	100 毫米×87 毫米 699 针 Molex Mirror Mezz 连接器 集成导热板				× 45 毫米 DIMM 连接器	100 毫米 x 79 毫米 x 21 毫米 (高度包括支 级板、模组和散热解决 方案)		× 45 毫米 DIMM 连接器